

V9

Soldadura en pasta no clean

SIN VACÍOS ES LA MEJOR OPCIÓN



NUEVO

CARACTERÍSTICAS

- Poco o ningún vacío, <1% en componentes BGA y <5% en BTC
- Cumple con las normas REACH y RoHS
- Volumen de impresión consistente en un área de ratio < 0.66
- Residuo claro, amigable con los pines de prueba y alta confiabilidad de los residuos
- Rendimiento de impresión estable durante +12hrs
- Disponible en SAC305 T4

¿ESTÁS BUSCANDO ELIMINAR VACÍOS?

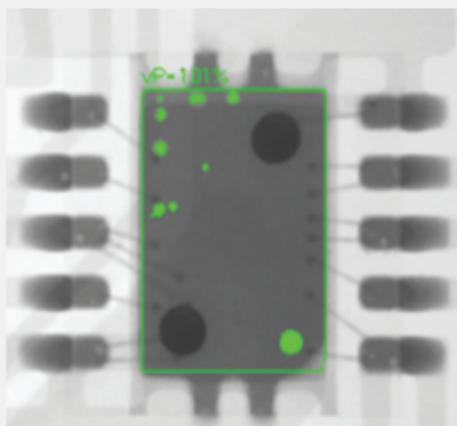
V9 es capaz de lograr el nivel de voids ultra bajos/ sin en los componentes BTC sin reflujo con vacío.

La pasta de soldadura **V9** no clean con nivel bajo de voids (vacíos) está diseñada específicamente para minimizar voids en todos los tipos de componentes, incluyendo QFN, LGA, BGA, D-PAK y otros componentes sensibles a los voids sin necesidad de reflujo con vacío. V9 reduce los voids hasta 1% en BGAs y <5% en BTCs, mientras que proporciona un rendimiento estable en impresiones con espacios ultrafinos con ratios de área <0,66 durante 12hrs. Sus residuos son claros, amigables con los pines de prueba y tienen altos valores de SIR, ideales para aplicaciones de alta confiabilidad. V9 está disponible en SAC305 T4 y es un "drop-in" para la mayoría de las pastas de soldadura no clean de AIM. ***Elimine los vacíos sin comprometer el rendimiento de la impresión con la nueva pasta de soldadura de bajo nivel de voids V9 de AIM.***

➤ **V9 Sin vacíos es la mejor opción.**

Contacta a tu representante de AIM para solicitar tu muestra sin costo.

Pasta de bajo nivel de vacíos **V9**
VACÍOS: $\leq 1\%$



Pasta típica de la competencia
VACÍOS: $\geq 9\% + UP$

